

歯科用合金／セラミックス複合材の接合界面評価

Evaluation of the Bonded Interface on Metal/Ceramics

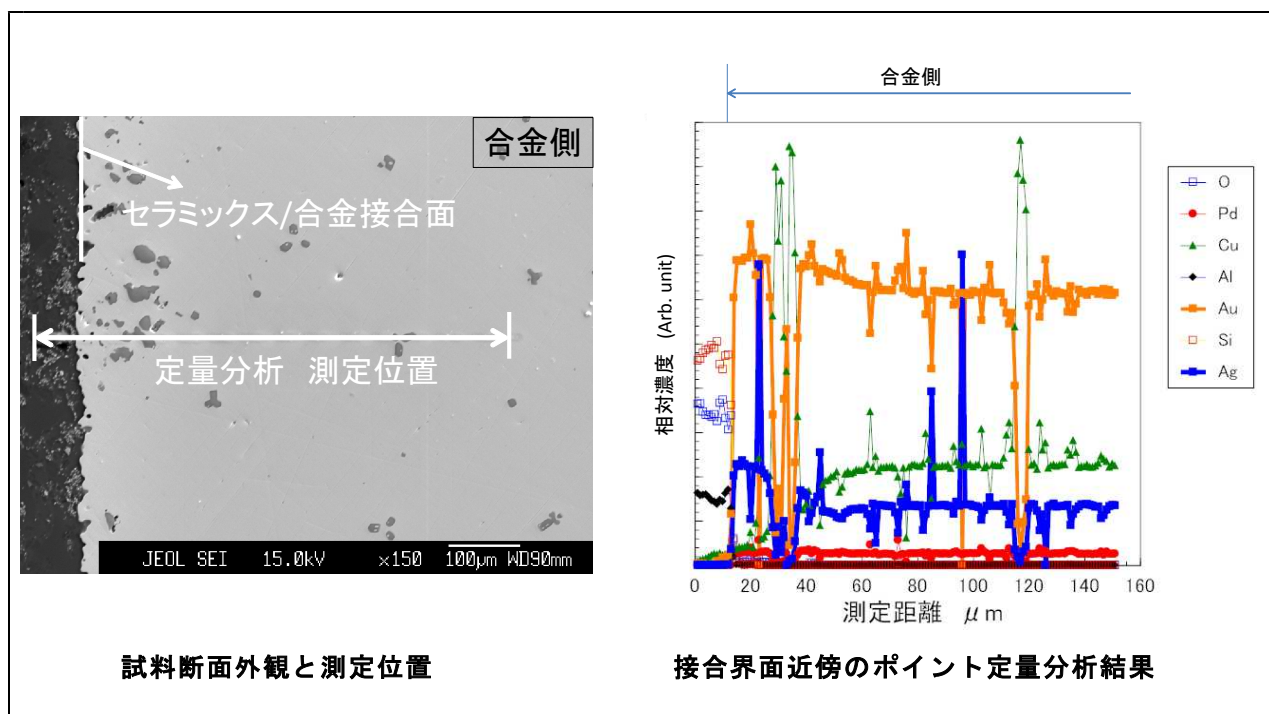
材料技術部 高橋 英徳

■ 支援の背景

依頼元では、歯科用合金とセラミックスの接合に関する研究開発を行っていますが、歯科用合金／セラミックスの接合界面での元素分布を評価する必要があります。そこで、電子線微小部分析(EPMA)を用いた分析・解析を行いました。

■ 支援の要点

1. 歯科用合金／セラミックスの接合界面での元素分布を明らかにする



■ 支援の成果

1. 歯科用合金／セラミックス接合試料について、従来の半定量的な分析に替わりポイント定量分析を連続的に行うことで接合界面での元素分布を明確化しました。
2. 歯科用合金／セラミックス接合試料の接合界面における各合金元素の挙動を明確化しました。

北海道医療大学

※本技術支援で使用した電子線微小部分析装置(EPMA)、はJKA補助事業により整備されました。